

『レーザプラットフォーム協議会』は、競争力のある高付加価値製品の開発に向けレーザ加工技術の活用を目指す企業の皆様のニーズに応え、レーザ加工に関する情報の提供から技術指導、試作事業化までトータルにサポートすることを目的とし、レーザ加工について高度な技術ポテンシャルと先端機器を有する大学・公設研究機関との連携の下に設立された団体です。

今年度より一般社団法人として再スタートするにあたり、より広範な地域でのフォーラム展開を目指しております。

さて、この度「ここまで来たレーザものづくりものづくり中小企業のレーザ導入事例」と題し、関東地域では初めてとなるフォーラムを開催いたします。

基調講演では世界のレーザ加工技術をリードしているドイツの現状を我が国の実情と比べながら紹介します。話題提供として装置メーカーから先端レーザ技術の紹介を、また、ユーザの立場からあまり知られていないレーザ応用の現状を紹介します。

レーザを利用したものづくり企業の皆様方にとって、有効な情報提供ができるものと考えております。万障お繰り合わせのうえご出席下さいますようお願い申し上げます。

参加をご希望の方は申込書に必要事項をご記入の上、10月29日(金)までにFAXあるいはメールにてお申込み下さいますようお願い致します。

■日 時：2010年11月10日(水) 13:00~17:05 (交流会 17:10~19:00)
 ■場 所：トルンプ株式会社
 (〒226-0006 横浜市緑区白山 1-18-2 ジャーマン・インダストリー・パーク B 1
 カンファレンス会場)
 地図：<http://www.jp.trumpf.com/>

■主 催：一般社団法人レーザプラットフォーム協議会(LPFP)
 ■共 催：産報出版株式会社
 ■後 援：レーザ加工学会、社団法人レーザー学会、社団法人粉体粉末冶金協会
 ■協 力：トルンプ株式会社
 ■定 員：70名 (定員になり次第締め切り)
 ■参加費：<フォーラム>レーザプラットフォーム協議会会員は無料
 非会員は5,000円/人
 <交流会>会員・非会員とも3,000円

■申込方法：参加申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。

■プログラム

1. 第2回フォーラム (13:00~17:05)

13:00 ~ 13:10	開会挨拶	
13:10 ~ 14:10	基調講演 「レーザ加工技術50年の歩み - 日本技術の復権に向けて - 」	
	一般社団法人レーザプラットフォーム協議会会長 大阪大学名誉教授/レーザ加工学会名誉会長	宮本 勇
14:10 ~ 14:50	話題提供 1 「アプリケーションに最適化された各種レーザ発振器と光学系による加工事例の紹介」	
	株式会社片岡製作所 先端レーザ研究所 主席研究員 副所長	小市 真樹 氏
14:50 ~ 15:00	休憩	
15:00 ~ 15:40	話題提供 2 「繊維およびその他への微細マーキング」	
	シキボウ株式会社 開発技術部次長	辻本 裕 氏
15:40 ~ 16:20	話題提供 3 「ディスクレーザを用いたレーザ加工の最新動向と板金向けアプリケーションの最先端」	
	トルンプ株式会社 YAG 溶接推進プロジェクト プロジェクトリーダー トルンプ株式会社 レーザ営業部 課長 セールス・エンジニア	岡 寛幸 氏 齋藤 茂樹 氏
16:20 ~ 17:00	トルンプ株式会社ショールーム見学 (デモンストレーション)	
17:00 ~ 17:05	閉会挨拶	

2. 交流会 (17:10~19:00)

交流会会場はジャーマン・インダストリー・パーク B 1 レストラン

お問い合わせ先：一般社団法人 レーザプラットフォーム協議会 担当：三原、柴崎、森
 〒581-0038 八尾市若林町 2 丁目 91 番
 TEL：072-948-3550 FAX：072-948-3560
 E-mail：info@laser-platform.com URL：<http://www.laser-platform.com>

講演内容

第2回フォーラム(13:00~17:05)

13:00-13:10 開会挨拶

13:10-14:10 基調講演

「レーザ加工技術50年の歩み - 日本技術の復権に向けて - 」

一般社団法人レーザプラットフォーム協議会会長
大阪大学名誉教授/レーザ加工学会名誉会長

宮本 勇

ドイツの大学でゲスト教授として長期滞在しているが、研究の傍らレーザセンターや大学の活動を見る機会が多い。ドイツのレーザ技術は世界最強であるばかりでなく近未来に雇用を創生する技術として国が強力に支援しており、産業界の関心も大変高い。いっぽう 1990 年代初頭にレーザ技術の世界最先進国であった我が国は今深刻な低迷期にあるが、その産業の活性化・差別化にレーザ技術は強力な切り札となると期待される。レーザ加工技術 50 年の歩みを振り返り、我が国のレーザ産業の復権について考える。

14:10-14:50 話題提供 1

「アプリケーションに最適化された各種レーザ発振器と光学系による加工事例の紹介」

株式会社片岡製作所 先端レーザ研究所 主席研究員 副所長 小市 真樹 氏

ランプ励起 Nd:YAG レーザに代わり高速・高品質を可能にした QCW-LD 励起 Nd:YAG レーザと、更にアルミニウム材の吸収率が高い LD 光を重畳させ同一ファイバ伝送を可能にしたハイブリッド LDYAG レーザ、また、UVYAG レーザと自由なテーパ形状が制御可能であり深穴加工を可能にする光学系等を加工事例とともに紹介する。

14:50-15:00 休憩

15:00-15:40 話題提供 2

「繊維およびその他への微細マーキング」

シキボウ株式会社 開発技術部次長 辻本 裕 氏

浜松工業技術支援センターと共同で繊維に対する精度の高いマーキング技術について研究を行い、レーザ光線により文字や画像を描くことが可能なポリエステル繊維を開発することに成功した。この繊維にレーザ光線をスポット照射し、直径 0.1mm のフィラメントに文字をマーキングした製品が、ブランド品の偽造防止のために使われている。繊維およびその他への微細レーザマーキングについて紹介する。

15:40-16:20 話題提供 3

「ディスクレーザを用いたレーザ加工の最新動向と板金向けアプリケーションの最先端」

トルンプ株式会社 YAG 溶接推進プロジェクト プロジェクトリーダー 岡 寛之 氏
トルンプ株式会社 レーザ営業部 課長 セールス・エンジニア 齋藤 茂樹 氏

我々がニュージェネレーションと呼ぶ新型ディスクレーザは、板金部品業界が求める溶接加工に最適なレーザ発振器と言える。励起用のダイオードの機能的な寿命は 50000 時間となりランニングコストの大幅な低減を実現している。また、製造コスト低減による発振機本体の価格もリーズナブルになった。ディスクレーザは、反射光に強い共振器構造であるため、ビードの滑らかなシームレス溶接や、銅などの鋼板材も溶接可能である。様々な加工を実現する加工装置も充実しており、ユーザの事業成長に合わせて、加工装置を拡張できるレーザネットワーク機能も他社にはない特徴である。ディスクレーザの板金業界におけるアプリケーションの数々を紹介する。

16:20-17:00 トルンプ株式会社ショールーム見学(デモンストレーション)

17:00-17:05 閉会挨拶

交流会(17:10~19:00)

ジャーマン・インダストリー・パークB1 レストラン